



## 第38回春季講演大会のご案内

日時：2024年3月13日(水)～15日(金)

場所：東京理科大学 野田キャンパス (千葉県野田市)

受付：講義棟1階 入口 (印刷した参加証をご持参ください)

【ハイブリッド開催：オンライン視聴可能】

《参加登録》

<https://jiep.or.jp/event/convention/jiep2024s/index.php>



### 1. 特別講演

3月14日(木) 7号館6階 講堂

【1】 15:10～16:10

#### 「宇宙居住を目指した地上・宇宙Dual開発の試み 地上エレクトロニクス技術の宇宙応用への期待」

東京理科大学 創域理工学部 電気電子情報工学科 教授  
スペースシステム創造研究センター長 **木村 真一 氏**



近年、月、火星など人類の宇宙進出が急速に広がりつつあります。このような宇宙進出を実現する広範な技術を効果的に開発するためには、宇宙専用を開発するのではなく、地上の技術との適切な連携が欠かせません。本講演では、地上-宇宙のDual開発を目指したスペースシステム創造研究センターの試みを紹介しつつ、様々な技術での連携の可能性を議論できればと思います。

【2】 16:20～17:20

#### 「2 nm時代を前にした半導体パッケージ技術」

Rapidus 株式会社 3Dアセンブリ技術部  
シニアディレクター **野中 敏央 氏**



ヘテロジニアスインテグレーション、チップレットなど、生成AIの学習向け等のハイエンド半導体パッケージの分野においては、More Transistor, More Memory の要求からロジックとメモリの複数チップを1パッケージへ集積することが進められている。これらを背景に2 nm世代以降のロジックチップを用いたパッケージ技術の動向を考えてみる。

2. 依頼講演 : 9件 予定

13日(水) ヘルスケア	「極薄ハプティックMEMSフィルムの開発」	産業技術総合研究所	竹下 俊弘 氏
カーエレクトロニクス	「パワー半導体実装用接合技術と高温動作モジュール」	大同大学	山田 靖 氏
配線板	「実装業界に影響を及ぼした環境規制動向」	NPO法人日本環境技術推進機構	青木 正光 氏
材料技術・環境	「半導体実装基板におけるめっき技術」	NPO法人サーキットネットワーク	大久保 利一 氏
14日(木) 3Dチップレット	「チップレット集積技術の最新動向」	東京工業大学	栗田 洋一郎 氏
15日(金) 部品内蔵・三次元	「部品内蔵基板の国際標準化活動」	福岡大学	加藤 義尚 氏
	「パワー半導体基板内蔵技術によるSiCベアダイ実装回路の研究」	STROM Lab. 名古屋大学	中村 和人 氏
光回路実装	「新しいデータセンタ応用光インターコネクットの動向と展望」	LitAhead	高井 厚志 氏
マイクロメカトロニクス	「エネルギー帯域選択型マルチスケールX線プロセスの構築と応用」	兵庫県立大学	内海 裕一 氏

3. チュートリアル講演 : 6件 3月13日(水)10:30~16:15 講義棟2階K206

「電子回路実装技術の役割、人材と将来」	国立大学法人 横浜国立大学	羽深 等 氏
「プリント配線板、サブストレートの基礎から最新動向」	よこはま高度実装技術コンソーシアム	八甫谷 明彦 氏
「なぜChipletなのか? -2010年代の実装技術からChipletの誕生まで-」	よこはま高度実装技術コンソーシアム	宮代 文夫 氏
「コンデンサ ~電子機器を支える縁の下の力持ち~」	NPO サーキットネットワーク	梶田 栄 氏
「電子機器の高度化・多様化で配線レス/基板レス実装構造が進む!」		
「一新たな方向に進展する電子機器実装の行方を探る」	よこはま高度実装技術コンソーシアム	本多 進 氏
「エレクトロニクス製品の品質・信頼性の課題」	Rapidus 株式会社	高橋 邦明 氏

4. 特別セッション:スマートプロセス学会 3月15日(金)13:10~15:50 講義棟2階K207

第20回有機/無機接合研究委員会 (4講演)

「高 Tgモールド樹脂を適用した高耐熱パワーモジュールパッケージの検討」	三菱電機株式会社	西原 孝太郎 氏
「FPCの特徴を活かした超薄型高圧電源の開発」	新電元工業株式会社	指田 和之 氏
「金属-樹脂接合の界面構造と接合メカニズム」	産業技術総合研究所	堀内 伸 氏
「微小柱せん断試験によるエポキシ接着剤の接着強度の評価」	千葉大学	山崎 泰広 氏

5. 一般講演 : 121件

13日 ヘルスケア	カーエレクトロニクス	高速伝送・回路実装	配線板	材料技術・環境調和	電子部品・実装
14日 サーマル・パワーエレクトロニクス	高速伝送・回路実装	3Dチップレット	官能検査システム	バウンダリスキャン技術	
15日 マイクロメカトロニクス実装	信頼性解析技術	光回路実装	インテリジェント実装	部品内蔵・三次元造形	

6. ポスターセッション : 9件 コアタイム : 14日12:00~14:00 講義棟1階K104 予定

田中貴金属工業(株)	木更津工業高等専門学校	電気通信大学	日東紡績(株)
甲南大学	日本曹達(株)	大阪有機化学工業(株)	東北大学
			京都先端科学大学

7. スポンサーセッション : 18社 コアタイム : 14日12:00~14:00 講義棟1階K104

						
						
						

【協賛団体】

IEEE EPS Japan Chapter, 映像情報メディア学会, 応用物理学会, 化学工学会, 関西サイエンス・フォーラム, KEC関西電子工業振興センター, 色材協会, 精密工学会, 電気化学会, 電気学会, 電子情報技術産業協会, 電子情報通信学会, 日本印刷学会, 日本機械学会, 日本光学会, 日本接着学会, 日本電子回路工業会, 日本電子材料技術協会, 日本時計学会, 日本熱物性学会, 日本ロボット工業会, 日本溶接協会, 光産業技術振興協会, 表面技術協会, 粉体粉末冶金協会, 溶接学会, レーザ加工学会, YUVEEC, JJC

主催 : 一般社団法人 エレクトロニクス実装学会  
〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2  
お問合せMail : E-mail: taikai38@jiep.or.jp  
ホームページ: <https://jiep.or.jp>



共催

 **東京理科大学**  
TOKYO UNIVERSITY OF SCIENCE  
共催  
 **エレクトロニクス生産科学部会**